



# *Investor Relations – 2020.4Q*

*Building a Better Future through convergence*



**soul**brain

### CONTENTS OF IR REPORT

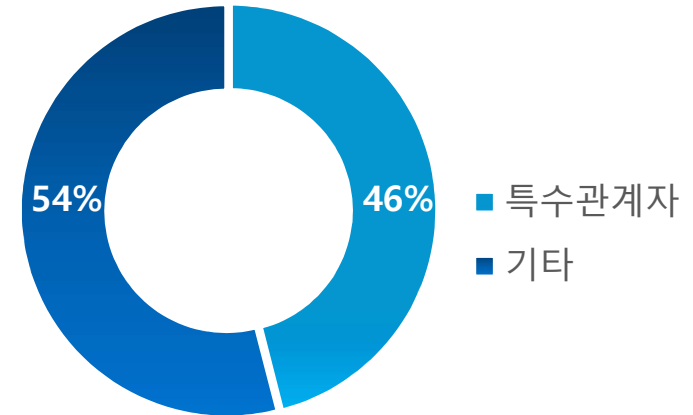
<i>회사 및 사업개요</i>	▪ <i>Page 2-3</i>
<i>요약 연결재무정보</i>	▪ <i>Page 4</i>
<i>요약 별도재무정보</i>	▪ <i>Page 5</i>
<i>반도체</i>	▪ <i>Page 6-8</i>
<i>디스플레이</i>	▪ <i>Page 9-11</i>
<i>2차전지</i>	▪ <i>Page 12</i>

### Corporate Outline

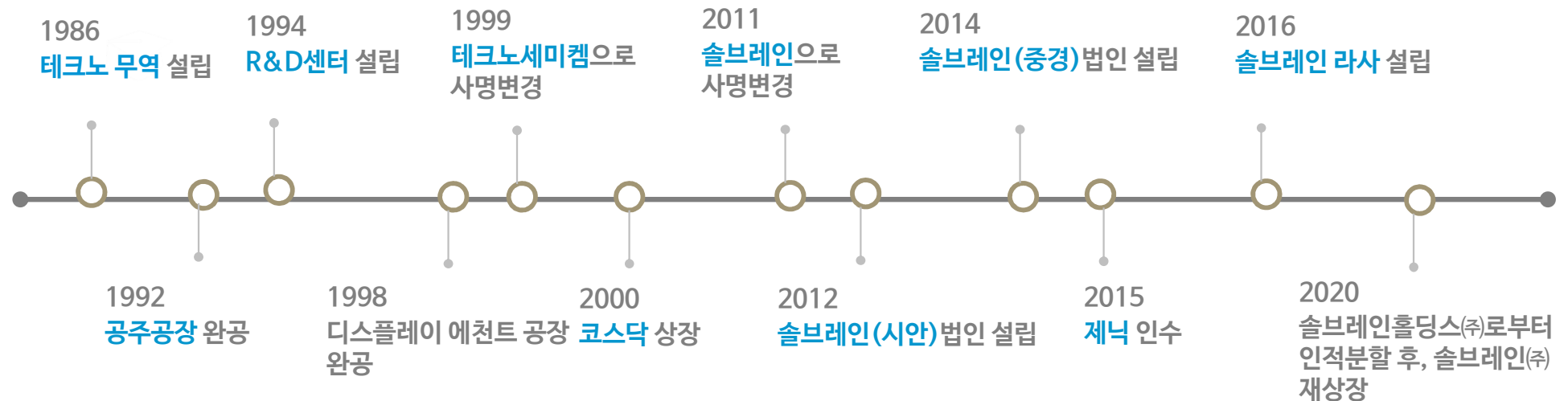
- 대표 : 노 환 철
- 설립일자 : 2020년 7월
- 자본금 : 38억
- 주요사업 : 반도체, 디스플레이, 2차전지 소재 생산
- 임직원 수 : 1,280명 (R&D staffs 150명)
- 본사 : 성남시 분당구 판교로 255번길 34
- 연구소(국내) : 공주, 파주, 판교중앙, 신갈



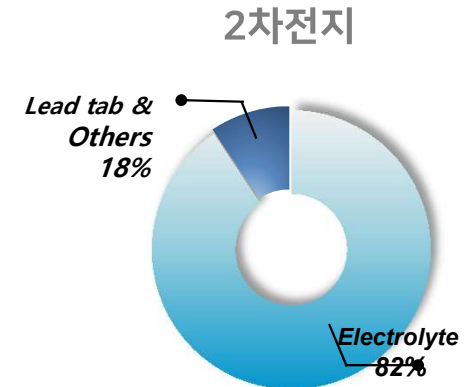
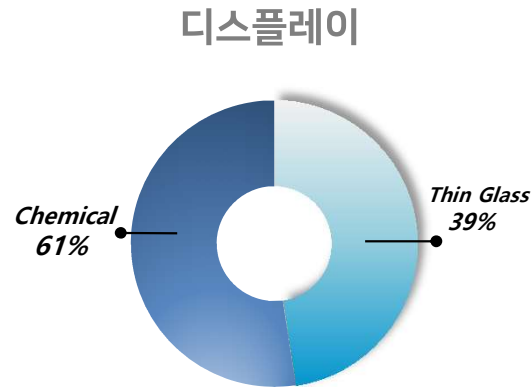
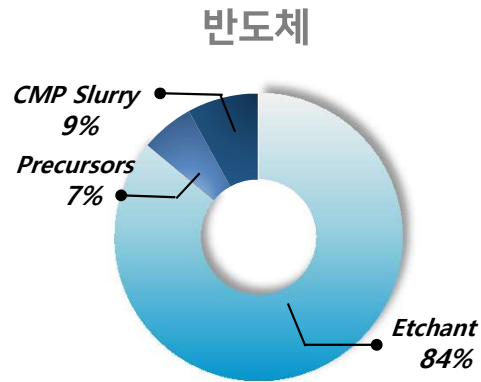
### Shareholders



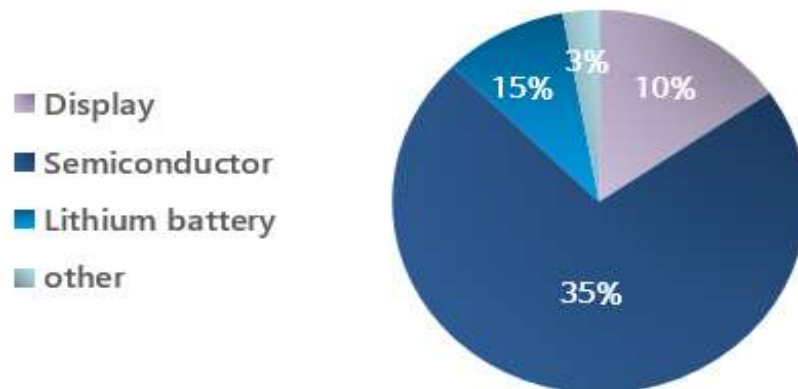
### Corporate History



### 제품별 비중 및 주요 고객사



### 사업부별 매출 비중



## ○ 재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)

구분	2020.3Q	2020.4Q	QoQ
유동자산	328,459	368,192	12%
비유동자산	351,463	349,554	-1%
<b>자산총계</b>	<b>679,923</b>	<b>717,745</b>	<b>6%</b>
유동부채	194,204	205,818	6%
비유동부채	2,468	3,476	41%
<b>부채총계</b>	<b>196,672</b>	<b>209,295</b>	<b>6%</b>
자본금	3,889	3,889	-
주식발행초과금	412,215	412,215	-
자기주식	-3,257	-3,257	-
기타자본항목	20,693	19,099	-8%
이익잉여금	36,992	63,267	71%
비지배지분	12,716	13,237	4%
<b>자본총계</b>	<b>483,251</b>	<b>508,450</b>	<b>5%</b>

## ○ 손익계산서(연결)

(단위 : 백만원)

구분	2020.3Q	2020.4Q	QoQ
<b>매출액</b>	<b>230,511</b>	<b>239,557</b>	<b>4%</b>
매출원가	158,589	176,161	11%
매출총이익	71,922	63,396	-12%
판매비와관리비	17,661	13,700	-22%
<b>영업이익</b>	<b>54,260</b>	<b>49,697</b>	<b>-8%</b>
기타수익	2,830	4,143	46%
기타비용	3,930	9,231	135%
금융수익	2,296	443	-81%
금융비용	3,542	8,015	126%
공동기업투자지분법손실	1,021	500	-51%
공동기업투자손상차손	-	1,370	-
<b>법인세차감전순이익</b>	<b>50,893</b>	<b>35,167</b>	<b>-31%</b>
법인세비용	12,805	8,372	-35%
<b>당기순이익</b>	<b>38,088</b>	<b>26,795</b>	<b>-30%</b>

## ○ 재무상태표(별도)

(단위 : 백만원)

구분	2020.3Q	2020.4Q	QoQ
유동자산	292,985	328,250	12%
비유동자산	324,497	327,534	1%
<b>자산총계</b>	<b>617,483</b>	<b>655,784</b>	<b>6%</b>
유동부채	166,360	179,287	8%
비유동부채	2,323	3,321	43%
<b>부채총계</b>	<b>168,683</b>	<b>182,608</b>	<b>8%</b>
자본금	3,889	3,889	-
주식발행초과금	412,215	412,215	-
자기주식	-3,257	-3,257	-
이익잉여금	35,952	60,329	68%
<b>자본총계</b>	<b>448,799</b>	<b>473,176</b>	<b>5%</b>

## ○ 손익계산서(별도)

(단위 : 백만원)

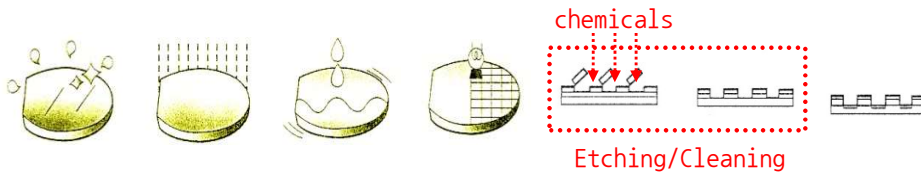
구분	2020.3Q	2020.4Q	QoQ
<b>매출액</b>	<b>223,047</b>	<b>230,368</b>	<b>3%</b>
매출원가	156,088	171,247	10%
매출총이익	66,958	59,121	-12%
판매비와관리비	16,379	12,994	-21%
<b>영업이익</b>	<b>50,580</b>	<b>46,126</b>	<b>-9%</b>
기타수익	2,608	3,484	34%
기타비용	4,082	9,072	122%
금융수익	179	620	246%
금융비용	1,279	7,332	473%
종속기업및공동기업 투자주식손상차손		1,512	-
<b>법인세차감전순이익</b>	<b>48,007</b>	<b>32,313</b>	<b>-33%</b>
법인세비용	12,055	7,936	-34%
<b>당기순이익</b>	<b>35,952</b>	<b>24,377</b>	<b>-32%</b>

# 반도체 Etching/Cleaning

## Key Points

### ▪ HF, B.O.E(Buffered Oxide Etchant) 등

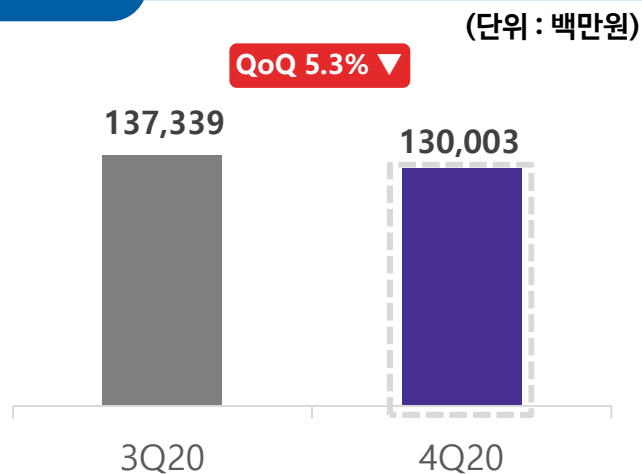
- HF & B.O.E : 반도체 공정 etching 및 cleaning에 사용되는 화학약품
- 원재료 내재화에 따른 경쟁력 강화 : 불화암모늄, 무수불산



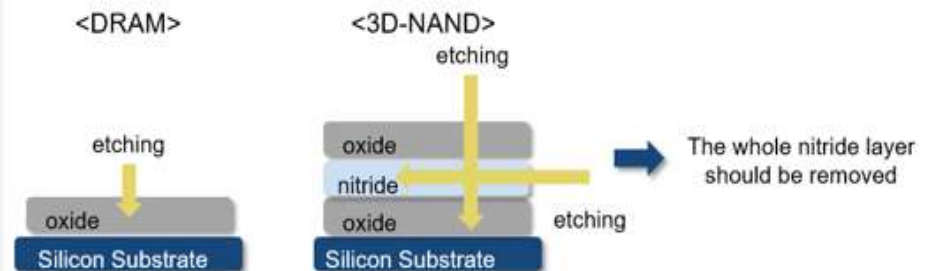
### ▪ 반도체 업체의 안정적인 생산 기대

- 주요 반도체 고객사 지속적인 라인 증설 수혜
- 공정변화에 따른 제품 대응 : pattern 미세화 & Process 복잡화, 고기능성 식각액 필요성 증대

## Sales Trend



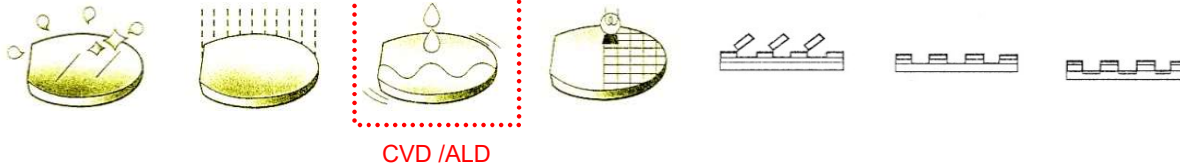
## Phosphoric etchant vs. HF etchant



### Key Points

#### ▪ CVD(Chemical Vapor Deposition), ALD(Atomic Layer Deposition) 재료

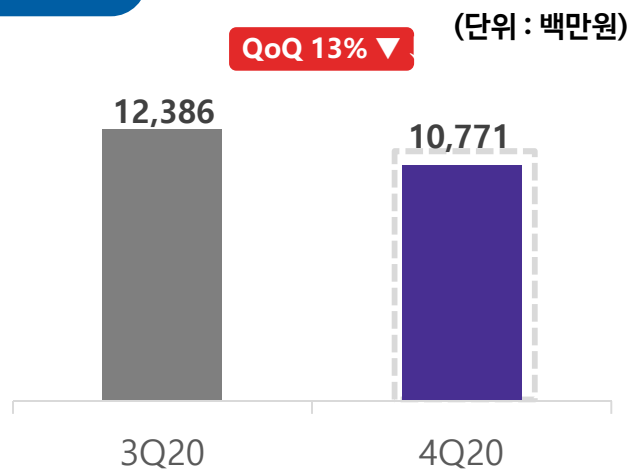
- 화학물질을 플라즈마 등을 이용 웨이퍼 위에 반응시켜 박막을 형성시키는 ‘박막 증착 공정’에 사용되는 전극재료(High-K), 저유전체(Low-K) 등
- 공정 미세화에 따라 신규 제품에 대한 수요 증대



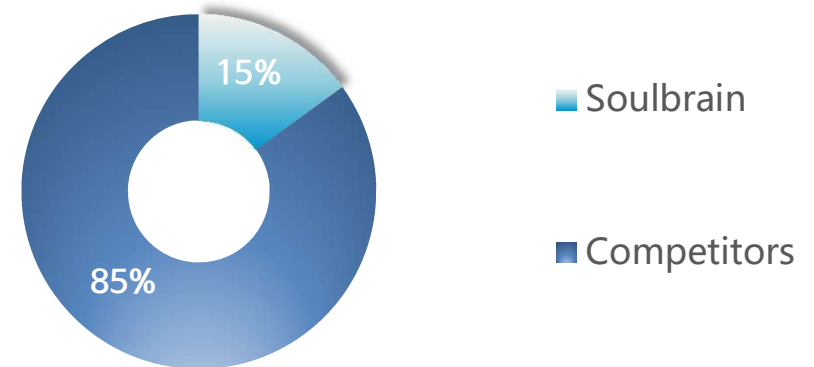
#### ▪ 신규 제품을 통한 매출 증가 기대

- 미세화, 고기능화에 적합한 차세대 신규 물질 지속 개발

### Sales Trend



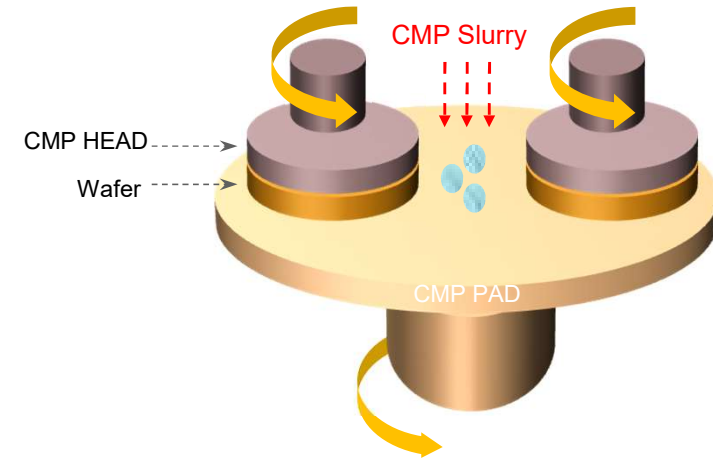
### Market Share



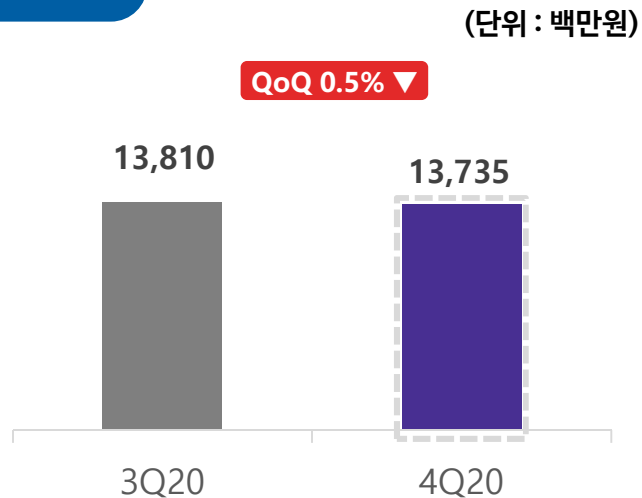


### Key Points

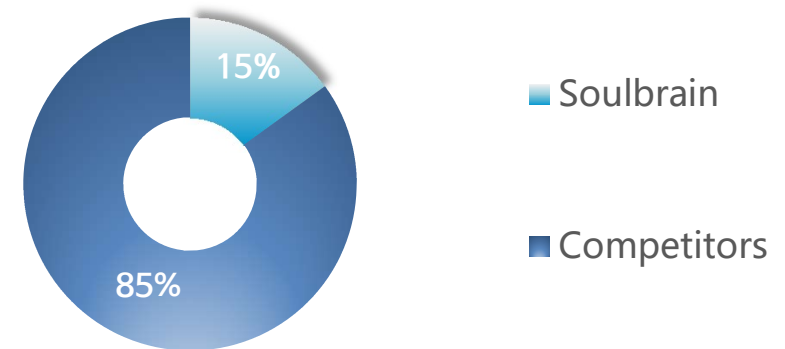
- **CMP(Chemical Mechanical Polishing) Slurry**
  - 반도체 박막 평탄화를 위한 연마 재료
    - : 연마 대상 막질에 따라 Ceria, W, Cu Slurry 등으로 구분됨
  - 반도체 공정 미세화에 따라 수요 증가
  
- **고객사 확대 노력 지속**
  - Ceria Slurry 점유율 확대노력 지속
  - 신규 Slurry 확대 노력 (Cu Slurry, W Slurry 신규 공급 기대)



### Sales Trend



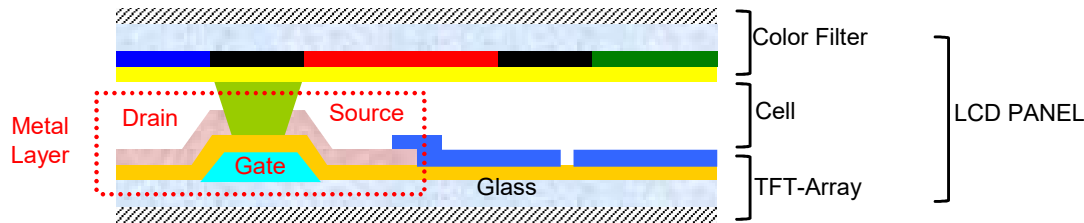
### Market Share



### Key Points

#### Etchant(식각액)

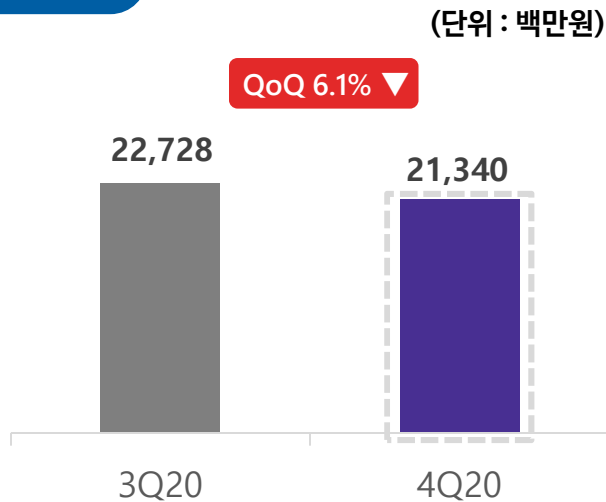
- 패턴을 형성하기 위하여 금속 배선의 필요하지 않은 부분을 선택적으로 제거하는 etching공정에 사용되는 화학 약품



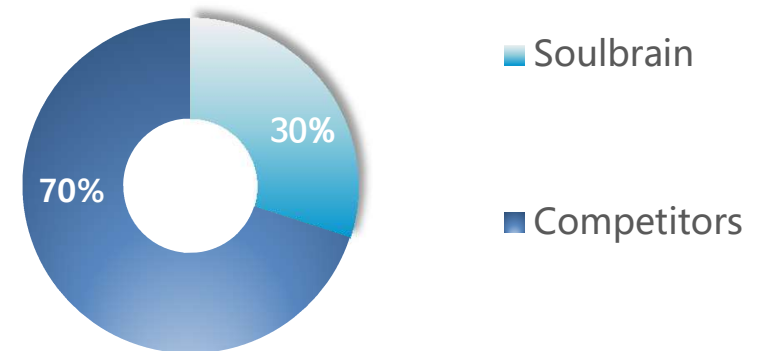
#### 기술 변화에 대한 대응

- O.L.E.D 시장 확대 : TFT-LCD와 유사한 O.L.E.D etching 공정

### Sales Trend

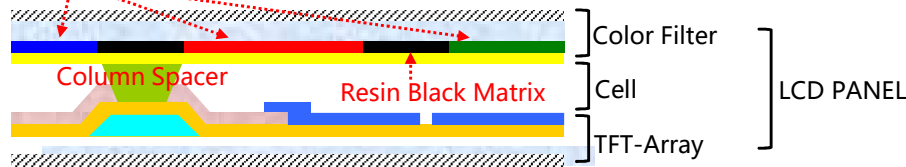


### Market Share (Al, Cu Etchant)



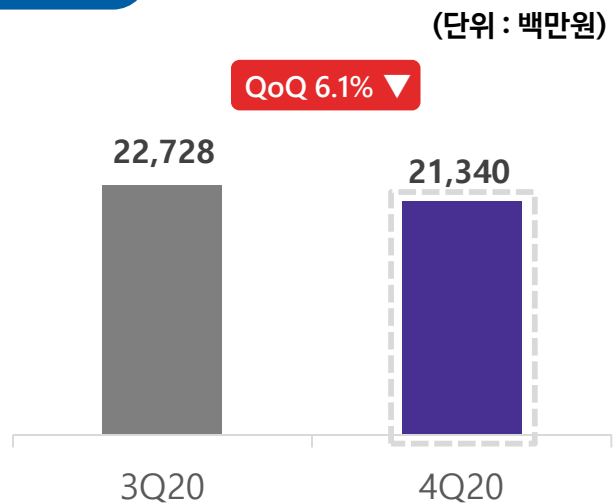
### Key Points

- 유기재료 : Black Matrix, Black Column Spacer, Color Resist 외
  - B.M : R.G.B 사이에서 빛의 투과를 막기 위하여 사용되는 유기 박막층
  - Black Column Spacer : LCD기판 사이의 간격을 유지시켜 주는 감광성 액체

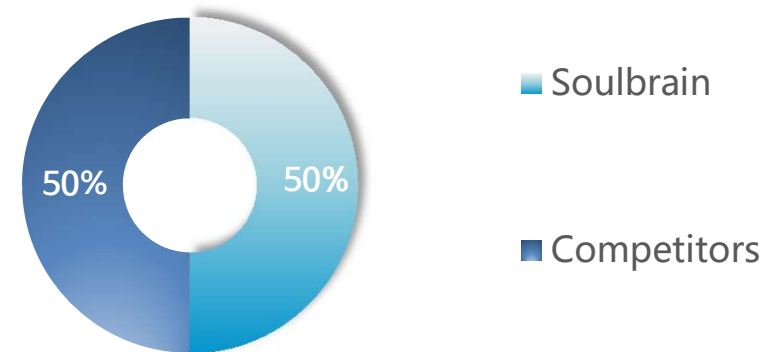


- 공급 제품 확대 노력
  - R.B.M → Column Spacer로 제품 확대 및 점유율 확대 노력
  - J/V(솔브레인 50 : 미쯔비시 화학 50) 역할 강화 : 연구, 제품 및 원재료 생산

### Sales Trend



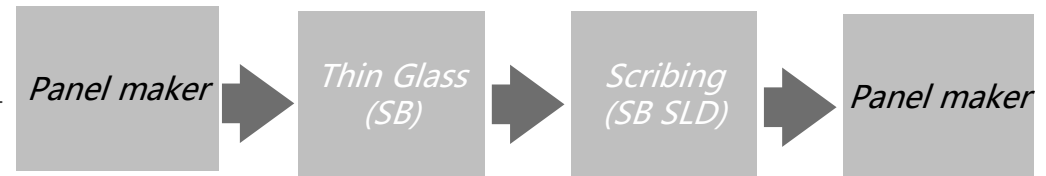
### Market Share ( B.M & B.C.S)



### Key Points

#### Thin Glass / Scribing(soulbrain SLD)

- Thin Glass : 화학적 방식(etching)으로 glass 두께 축소
- Scribing : 물리적 방식으로 패널을 셀 사이즈에 맞게 절단



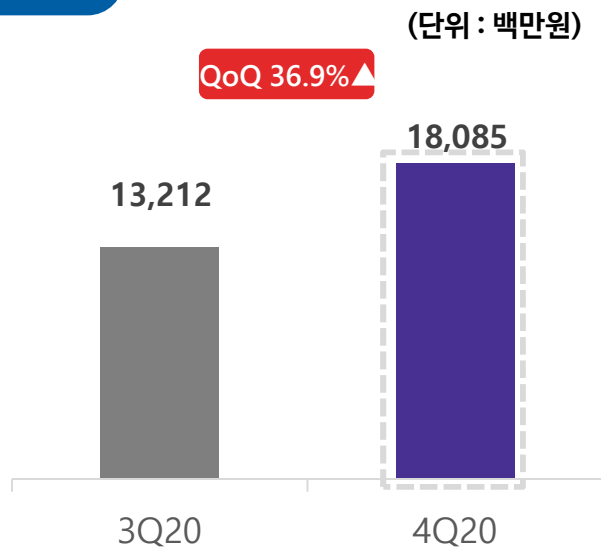
#### 스마트폰 등 관련 제품 생산량과 연동

- 모바일 기기 필수 공정 : 두께, 무게 등이 중요한 모바일 기기에 적합
- Rigid type 수요에 따른 생산량 변동

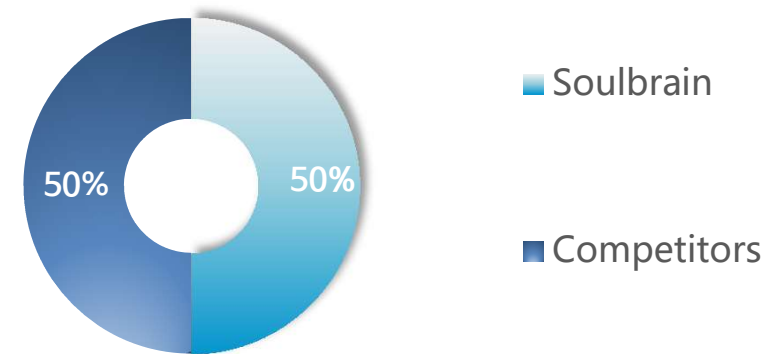
#### Thin Glass 선두 업체로서 안정적 시장점유율 유지

- T.G와 관계사 솔브레인SLD의 Scribing 일괄 진행으로 공정 효율성 확보

### Sales Trend



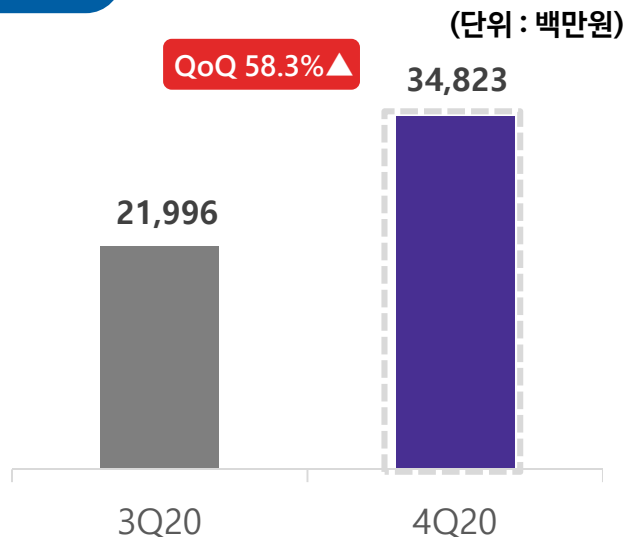
### Market Share (Thin Glass at SDC)



### Key Points

- 2차 전지 전해액 / Lead Tab
  - 전해액 : 음극과 양극 사이의 원활한 이동을 유도하는 화학 혼합물
  - Lead Tab : 전지에서 발생한 에너지를 device로 전달하는 역할
- IT용 2차 전지 시장의 안정적 성장
  - 2차 전지 필수 소재
  - IT용 전지 수요의 지속적 증가: 스마트폰, 테블릿 PC 등
- E.V 등 대용량 2차 전지 시장의 본격화 기대
  - 전지 업체와의 공동기술개발 등 진행
  - 한국, 미국, 말레이시아 3개 지역 생산 시설 보유

### Sales Trend



### Market Share (In Samsung SDI)

